平成25年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年3月8日

上場会社名　株式会社 SUMCO　　上場取引所　東
コード番号　3436　URL　http://www.sumcosi.com/
代表者　(役職名) 取締役社長　(氏名) 橋本 眞幸
問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR室長　(氏名) 澁谷 博史　TEL 03-5444-3915

定時株主総会開催予定日　平成25年4月25日　配当支払開始予定日　平成25年4月26日
有価証券報告書提出予定日　平成25年4月25日
決算補足説明資料作成の有無　：　有
決算説明会開催の有無　：　有　(機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年1月期の連結業績(平成24年2月1日～平成25年1月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年1月期	206,691	△16.4	13,215	—	9,464	—	3,426	—
24年1月期	247,177	△10.8	967	—	△5,695	—	△84,369	—

(注)包括利益　25年1月期　8,552百万円　(—%)　24年1月期　△88,126百万円　(—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
25年1月期	8.93	—	2.6	2.0	6.4
24年1月期	△327.33	—	△55.2	△1.1	0.4

(参考) 持分法投資損益　25年1月期　—百万円　24年1月期　—百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年1月期	493,334	180,325	32.2	436.94
24年1月期	436,420	126,773	25.1	424.47

(参考) 自己資本　25年1月期　158,746百万円　24年1月期　109,406百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
25年1月期	16,308	△15,228	47,502	72,103
24年1月期	18,916	△17,472	△29,583	25,464

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
24年1月期	—	0.00	—	0.00	0.00	0	0.0	0.0
25年1月期	—	0.00	—	2.00	2.00	515	22.4	0.5
26年1月期(予想)	—	—	—	—	—		—	

(注)現時点において平成26年1月期の1株当たり配当金については未定であります。
(注)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、サマリー情報3ページの「(参考)A種種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 平成26年 1月期の連結業績予想(平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	100,000	△8.0	10,000	45.0	5,000	△5.6	1,000	△79.9	1.70
通期	210,000	1.6	26,000	96.7	18,000	90.2	12,000	250.2	42.19

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 ―社 (社名) 、 除外 ―社 (社名)
(注)詳細は、添付資料 7ページの「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 有
③ 会計上の見積りの変更 : 有
④ 修正再表示 : 無
(注)詳細は、添付資料 16ページの「会計方針の変更」及び「会計上の見積りの変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年1月期	257,751,739 株	24年1月期	257,751,739 株
② 期末自己株式数	25年1月期	5,166 株	24年1月期	4,866 株
③ 期中平均株式数	25年1月期	257,746,762 株	24年1月期	257,746,974 株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、添付資料 19ページの「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

平成25年1月期の個別業績(平成24年2月1日～平成25年1月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年1月期	169,467	△18.3	9,751	288.4	7,087	973.5	9,038	―
24年1月期	207,337	△10.9	2,510	―	660	―	△97,359	―

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
25年1月期	30.70	30.40
24年1月期	△377.73	―

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年1月期	456,824	160,554	35.1	443.96
24年1月期	390,256	110,106	28.2	427.19

(参考) 自己資本 25年1月期 160,554百万円 24年1月期 110,106百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きを実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、添付資料 2ページの「経営成績に関する分析」をご覧ください。

平成26年1月期の1株当たり配当金については未定としております。当該予想の開示が可能となった時点で速やかに開示する所存であります。詳細は、添付資料 3ページの「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。

当社は平成25年3月8日に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ウェブサイトに掲載する予定です。

（参考）A種種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

A種種類株式	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年 1月期	―	―	―	―	―
25年 1月期	―	―	―	2,500,000.00	2,500,000.00
26年 1月期（予想）	―	―	―	―	―

（注）現時点において、平成26年1月期の1株当たり配当金については未定であります。

【添付資料】

添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析
（１）経営成績に関する分析・・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（２）財政状態に関する分析・・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当・・・・・・・・・・ P. 3
（４）事業等のリスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3

２．企業集団の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 7

３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8
（２）中長期的な会社の経営戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8
（３）会社の対処すべき課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8

４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 9
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・ P.11
（３）連結株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15
（５）継続企業の前提に関する注記　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
（６）会計方針の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
（７）会計上の見積りの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
（８）連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.17

１．経営成績・財務状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度におけるシリコンウェーハ市場は、パソコン需要が伸び悩んだものの、上半期はスマートフォンやタブレットなどの需要に下支えされ、300㎜ ウェーハを中心に堅調に推移しました。下半期に入ると、牽引していた先端デバイス製品の需要減退に伴う半導体の生産調整を受け、シリコンウェーハも在庫調整局面となりました。

当社グループは、昨年２月２日に発表いたしました「事業再生計画」を実行するとともに、前述のような事業環境の変化のもと、更なる間接費の削減・コスト合理化を遂行し、損益分岐点の改善により収益の確保を図ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高 206,691 百万円、営業利益は 13,215 百万円、経常利益は 9,464 百万円となりました。また、特別損失として希望退職に係る事業構造改善費用 7,271 百万円を計上した結果、当期純利益は 3,426 百万円となりました。

②次期の見通し

2012 年度下半期に始まった半導体用シリコンウェーハの在庫調整は、想定よりも厳しいものの、上期後半には回復局面に入ると予想しております。

半導体市場を牽引するスマートフォン・タブレット等は引き続き成長が見込まれますが、300㎜ ウェーハは微細化の進展により緩やかな成長となります。また、小径ウェーハは需要構造の変化と大径ウェーハへの移行によりマイナス成長が続くことから、シリコンウェーハ需要は伸び悩むものと予想しております。

このような市場見通しのもと、当社グループは、更なるコスト合理化を図り、景気下降局面でも収益を確保できる収益基盤の強化を推進してまいります。

平成 26 年 1 月期の連結業績予想につきましては、本決算短信（サマリー情報）の当該欄に記載の通り予想いたしました。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 56,913 百万円増加し、493,334 百万円となりました。設備投資の圧縮と償却の進行等により有形固定資産が 12,743 百万円減少した一方で、譲渡性預金の購入により有価証券が 37,000 百万円増加したこと、長期供給契約に基づく原材料の購入等により原材料及び貯蔵品が 37,703 百万円増加したことがその主な要因であります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 3,360 百万円増加し、313,008 百万円となりました。短期及び長期の借入金及びリース債務合計で 4,921 百万円増加したことがその主な要因であります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 53,552 百万円増加し、180,325 百万円となりました。第三者割当増資により 45,000 百万円増加したこと、当期純利益 3,426 百万円を計上したこと、及び少数株主持分が 4,213 百万円増加したことがその主な要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 46,639 百万円増加し、72,103 百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが 16,308 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△15,228 百万円、及び財務活動によるキャッシュ・フローが 47,502 百万円となったこと等によるものであります。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,608百万円減少し、16,308百万円となりました。これは、税金等調整前当期純損益が改善された一方で、減価償却費が減少したこと、及びたな卸資産の増加によりキャッシュ・フローが悪化したことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が 2,244 百万円減少し、△15,228百万円となりました。これは、有形・無形固定資産の取得による支出が減少したことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動キャッシュ・フローは、47,502百万円となりました。これは第三者割当増資により株式の発行による収入44,766百万円が増加したことが主な要因であります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成21年1月期	平成22年1月期	平成23年1月期	平成24年1月期	平成25年1月期
自己資本比率 (%)	49.8	39.9	35.0	25.1	32.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	41.9	60.6	57.4	38.6	49.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	2.2	38.9	9.1	12.4	14.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	47.2	1.9	6.1	4.9	4.9

自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
（注１） いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。
（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。
（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の剰余金の配当に関する基本方針は、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、決定していくこととしております。

なお、当期の普通株式期末配当金につきましては、１株当たり２円を予定しております。

また、平成26年1月期の普通株式配当予想につきましては、現時点においては未定とさせていただきます。

（４）事業等のリスク

当社グループは、以下のような事項を当社グループの経営並びに事業遂行上の主要なリスク要因と認識しており、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、これらの要因により、当社グループの事業、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

① 事業環境について

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、各種半導体の基板等に用いられるものであることから、半導体及びその周辺産業等に特徴的な諸要因の影響を受けることがあります。かかる諸要因には、半導体業界における急激な市況悪化、半導体及びその周辺産業等における急速な技術革新の進展、製品の陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落、特定顧客との取引の集中とその特定顧客からの受注の大幅な変動、同業他社との競争優位性の変化に伴う当社グループの競争力の変動、及び顧客需要の大きな振幅等があり、これらは当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）及び三菱マテリアル株式会社グループのシリコンウェーハ事業を統合した会社であり、両社は現在も当社の主要株主であります。当社グループと両社との関係の変化により、当社グループは将来において影響を受ける可能性があります。

② 当社グループの製品について

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後は普及による販売数量拡大等の影響もあり、一般的に低下する傾向にあります。当社グループにおいては、量産化による販売数量の拡大や製造工程等における歩留率向上等の合理化を進めることにより、当該製品価格低下を想定した事業計画を策定しておりますが、急激な市況悪化その他の事由により想定以上の販売価格低下が生じる場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、上記以外にも、品質の不適合（具体的には、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しない場合、または不適合等が生じる場合に重大な品質クレームを引き起こす可能性）、生産性向上の未達成等（具体的には、製品製造工程における歩留率改善等による継続した生産効率の向上が図られない場合の利益の圧迫要因、もしくは製造設備の事故やその他の要因による製造の中断、あるいは大幅な遅延等が生じる場合に、当社グループ全体の生産能力低下や特定製品の供給が困難となる可能性等）が当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 原材料の調達について

シリコンウェーハの主要原材料は、極めて純度の高い多結晶シリコンであり、製造者が限定されていることから、供給不安のリスクがあります。そのため、当社グループは、世界の主要な多結晶シリコンメーカーとの間で、多結晶シリコンメーカーが一定期間に一定の数量を供給し、当社グループが購入する旨の長期購入契約を締結し、原材料の安定調達を図ってまいりました。しかしながら、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予想と足元の消費見通しに乖離が生じており、今後も在庫が増加する見通しであります。たな卸資産増加によるキャッシュ・フローへの影響は、「会社の対処すべき課題」において記載した通りでありますが、事業環境の著しい変化等により、消費量が変動した場合、あるいは、会計上の対応が必要となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

④ 主要製造設備の安定調達について

当社の主要製造設備には、当社と設備機器メーカーとの間で共同開発した両面研磨機等、他メーカーへの切り替えができない設備があります。これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 顧客及びサプライヤーに係るリスク（経営破綻・操業停止等）について

当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、仮に顧客が倒産し、多額の売上債権が回収不能となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は諸資材の調達については、複数のメーカーと契約する等、調達途絶リスクを回避する施策を講じておりますが、経済環境の急激な悪化やサプライヤーの設備事故等による操業停止あるいは倒産等により、諸資材等の調達に支障を来たす場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 設備投資について

当社グループは中長期的な需要予測に基づいて設備投資を実施しておりますが、経済動向や半導体業界を

取り巻く環境の変化により、需要予測に大幅な変化が生じる場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 資金調達について

当社グループのシンジケート・ローン契約等につきましては、財政状況の著しい悪化により、その財務制限条項に抵触し、当該借入金について返還請求を受けた場合には、期限の利益を失い、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 技術及び研究開発について

半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、細密化や半導体用途の多様化、高精度化及び生産効率の向上等、当社グループのシリコンウェーハに対して顧客より要求される各種技術は多岐に亘り、且つ、高度化しております。当社グループは、かかる顧客からの要求に応えるため、中長期的に需要の拡大が見込まれる300㎜ウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェーハやアニールウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重点をおいた研究開発活動を行っております。

しかしながら、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適合することが困難となり、研究開発活動が想定した効果を得られない場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 知的財産権について

当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を保有しております。

また、当社グループは、大重量結晶の製造、無欠陥結晶、高精度の両面研磨技術等に関する基本特許を保持しておりますが、さらに、これら特許から発展した技術及び周辺技術についても特許の出願を進めております。

しかしながら、当社グループが認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 海外展開について

当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しておりますが、生産及び販売活動については、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し事業を展開しております。当社グループのこれらの生産及び販売活動には、為替変動リスクがあるほか、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制、為替規制等の変化による影響や、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、社会・労働慣行の相違、社会的インフラの未整備等による影響を受ける可能性があります。

⑪ 環境規制等について

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気、排水、有害化学物質の使用及び保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があります。また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後において環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな費用負担等が生じることが予想され、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 自然災害、事故等のリスクについて

当社グループの各製造拠点において、台風、豪雨、地震、津波または火山活動等の自然災害や、事故、火災、テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生する場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社グループの主力商品である300㎜ウェーハの加工工程を有する製造拠点が、上記の自然災害、事故、火災等に見舞われる場合、300㎜ ウェーハの製造・販売に支障を来たし、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 企業買収に関するリスクについて

当社は、企業買収の実施に当たり、当該企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化等、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 上記以外のリスクについて

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼすことがあります。

a. 事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。
b. 退職給付債務に関して、今後当社の年金資産の時価の下落、運用利回りの低下、または退職給付債務を計算する数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。
c. 経済環境の変化等により、将来の収益等の見積りが大幅に変動する等、会計上の対応が必要となる場合。
d. 外部環境の変化等により当社グループが想定する以上の資金需要が生じる場合、あるいは金融機関との契約により期限の利益を喪失する場合、また、金利水準や市場環境等の要因により当社グループが希望する時期または条件により資金調達が実行できない場合。

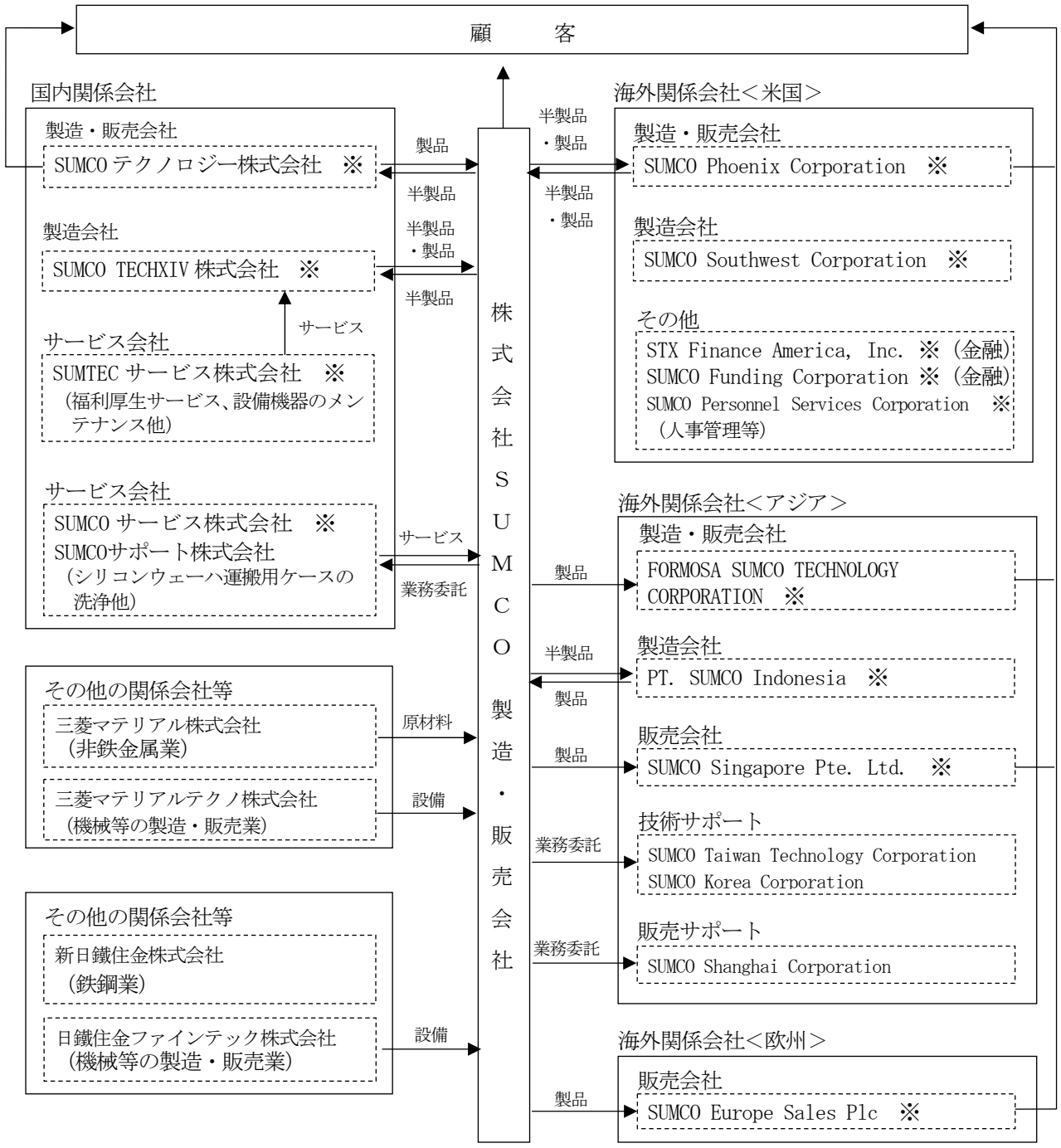
２．企業集団の状況

当社の関係会社は国内子会社７社（連結子会社４社、非連結子会社３社）及び海外子会社１２社（連結子会社９社、非連結子会社３社）であります。また、当社のその他の関係会社は新日鐵住金株式会社と三菱マテリアル株式会社であり、当社は当該両社のグループに属しております。

当社と当社の子会社で構成されるグループ（以下「当社グループ」といいます。）の事業は「高純度シリコン事業」のみであります。

［事業系統図］

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（※は連結子会社）



当連結会計年度において、水俣電子株式会社は清算し、ジャパンスーパークォーツ株式会社は当社に吸収合併しました。また、SUMCO ソーラー株式会社は現在清算中であります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは「お客様と株主の期待に応え、従業員に幸せを与え、社会に貢献する、常に世界一のシリコンウェーハメーカーを目指す」という経営理念のもと、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献してまいります。特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の向上に傾注し、シリコンウェーハ業界における地位の維持・向上を図ってまいります。

当社グループは、この基本方針のもと、事業基盤を更に強化し、事業の持続的成長を目指し、ステークホルダーの負託に応えてまいる所存であります。

（２）中長期的な会社の経営戦略

半導体シリコンウェーハのうち300㎜ウェーハは、変動要因はあるものの半導体市場の需要伸張とともに市場は拡大していく見通しであります。200㎜以下のウェーハは300㎜ウェーハへの移行もあり需要が徐々に低下していく見通しであります。

このような環境の中、主力製品である300㎜ウェーハについては、販売価格の是正を図りつつ、需要拡大や製品の高精度化・微細化の要求に適切に対応してまいります。200㎜以下のウェーハについては、設備規模の適正化を図るべく生産体制の再編を遂行し、集中生産と高効率操業を実現してまいります。また、コスト競争力の強化や高品質化への対応により、収益性の改善に努めてまいります。

（３）会社の対処すべき課題

当社グループでは、昨年２月に発表いたしました ①ソーラー事業からの撤退、②需要の減少が見込まれる小径事業を主体とした生産拠点の更なる再編によるコスト競争力の維持・強化、③これら生産体制の最適化に対応した希望退職の募集を主な内容とする要員体制の見直しを骨子とする「事業再生計画」を進めると共に、投資の効率化や更なる間接費の圧縮等による合理化を強力に推進し、当連結会計年度は４期ぶりに黒字化を達成いたしました。

しかしながら、足許の為替は円安傾向にあるものの、世界経済には依然として不透明感が強いことなど、今後の事業環境については予断を許さない状況にあります。係る状況下、事業環境の変化に対応した施策を適宜実行することにより、さらなる収益基盤の強化及び持続的成長の実現に向け変革を進めてまいります。

なお、シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンにつきましては、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予測と足元の消費見通しに乖離が生じていることにより、現在余剰在庫を保有しており、今後も在庫が増加する見通しであります。当連結会計年度におけるたな卸資産増加によるキャッシュ・フローへの影響額は、△305億円であり、平成26年１月期においては△240億円程度の影響が見込まれます。適正水準への回復のため調達先との契約改定等鋭意対策を実施してまいりました。今後はたな卸資産の増加ペースは漸減する見通しであり、中長期的には適正水準に回復する見込みであります。今後も適正水準回復の早期実現に向けて、調達先との継続的な交渉を通して対応を図ってまいります。

４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （平成24年１月31日）	当連結会計年度 （平成25年１月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,464	35,103
受取手形及び売掛金	36,181	32,457
有価証券	―	37,000
商品及び製品	15,530	17,030
仕掛品	14,527	11,229
原材料及び貯蔵品	47,095	84,798
繰延税金資産	215	161
その他	12,008	9,091
貸倒引当金	△116	△131
流動資産合計	150,906	226,741
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	187,076	190,304
減価償却累計額	△88,507	△94,815
建物及び構築物（純額）	98,568	95,488
機械装置及び運搬具	706,005	723,436
減価償却累計額	△655,386	△676,887
機械装置及び運搬具（純額）	50,619	46,549
土地	20,178	20,235
建設仮勘定	21,769	16,328
その他	13,311	13,798
減価償却累計額	△12,343	△13,039
その他（純額）	967	759
有形固定資産合計	192,104	179,360
無形固定資産		
のれん	16,868	15,231
ソフトウエア	3,266	2,365
その他	213	248
無形固定資産合計	20,348	17,844
投資その他の資産		
投資有価証券	897	118
長期前渡金	62,051	58,094
長期前払費用	4,030	3,991
繰延税金資産	4,893	5,925
その他	1,541	1,628
貸倒引当金	△353	△370
投資その他の資産合計	73,060	69,387
固定資産合計	285,513	266,592
資産合計	436,420	493,334

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年１月31日)	当連結会計年度 (平成25年１月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	26,661	28,658
短期借入金	95,693	125,308
リース債務	9,545	9,074
未払法人税等	484	236
賞与引当金	2,452	2,171
設備関係支払手形及び設備関係未払金	6,229	2,332
その他	13,454	17,506
流動負債合計	154,521	185,287
固定負債		
長期借入金	118,298	103,150
リース債務	11,485	2,410
繰延税金負債	1,332	512
再評価に係る繰延税金負債	1,559	1,559
退職給付引当金	18,844	17,544
その他	3,606	2,542
固定負債合計	155,126	127,721
負債合計	309,647	313,008
純資産の部		
株主資本		
資本金	114,107	136,607
資本剰余金	89,291	15,676
利益剰余金	△82,692	16,849
自己株式	△8	△8
株主資本合計	120,697	169,124
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	149	0
繰延ヘッジ損益	10	△3,431
土地再評価差額金	2,671	2,671
為替換算調整勘定	△14,121	△9,618
その他の包括利益累計額合計	△11,290	△10,378
少数株主持分	17,366	21,579
純資産合計	126,773	180,325
負債純資産合計	436,420	493,334

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成23年２月１日 至　平成24年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）
売上高	247,177	206,691
売上原価	218,097	169,895
売上総利益	29,079	36,795
販売費及び一般管理費	28,112	23,579
営業利益	967	13,215
営業外収益		
受取利息	47	34
受取配当金	41	141
為替差益	170	－
固定資産売却益	462	80
助成金収入	171	941
その他	499	570
営業外収益合計	1,393	1,768
営業外費用		
支払利息	3,751	3,237
為替差損	－	680
減価償却費	3,353	417
固定資産除売却損	403	133
支払補償費	135	614
その他	412	437
営業外費用合計	8,056	5,520
経常利益又は経常損失（△）	△5,695	9,464
特別利益		
受取補償金	10,003	1,391
退職給付信託設定益	－	319
特別利益合計	10,003	1,711
特別損失		
事業構造改善費用	58,115	7,271
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	560	－
災害による損失	1,269	－
特別損失合計	59,945	7,271
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△55,637	3,903
法人税、住民税及び事業税	657	302
法人税等調整額	27,790	△1,066
法人税等合計	28,448	△763
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△）	△84,085	4,667
少数株主利益	283	1,240
当期純利益又は当期純損失（△）	△84,369	3,426

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自　平成23年２月１日 至　平成24年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△）	△84,085	4,667
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△702	△149
繰延ヘッジ損益	△19	△3,441
土地再評価差額金	212	－
為替換算調整勘定	△3,531	7,475
その他の包括利益合計	△4,040	3,885
包括利益	△88,126	8,552
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△86,988	4,339
少数株主に係る包括利益	△1,138	4,213

（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成23年２月１日 至　平成24年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）
株主資本		
資本金		
当期首残高	114,107	114,107
当期変動額		
新株の発行	－	22,500
当期変動額合計	－	22,500
当期末残高	114,107	136,607
資本剰余金		
当期首残高	89,291	89,291
当期変動額		
新株の発行	－	22,500
欠損填補	－	△96,115
当期変動額合計	－	△73,615
当期末残高	89,291	15,676
利益剰余金		
当期首残高	1,883	△82,692
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失（△）	△84,369	3,426
土地再評価差額金の取崩	△206	0
欠損填補	－	96,115
当期変動額合計	△84,576	99,542
当期末残高	△82,692	16,849
自己株式		
当期首残高	△8	△8
当期変動額		
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0
当期末残高	△8	△8
株主資本合計		
当期首残高	205,274	120,697
当期変動額		
新株の発行	－	45,000
当期純利益又は当期純損失（△）	△84,369	3,426
土地再評価差額金の取崩	△206	0
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△84,577	48,427
当期末残高	120,697	169,124
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	852	149
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△702	△149
当期変動額合計	△702	△149
当期末残高	149	0
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	29	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△19	△3,441
当期変動額合計	△19	△3,441
当期末残高	10	△3,431

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自　平成23年２月１日 至　平成24年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日)
土地再評価差額金		
当期首残高	2,252	2,671
当期変動額		
土地再評価差額金の取崩	206	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	212	―
当期変動額合計	419	△0
当期末残高	2,671	2,671
為替換算調整勘定		
当期首残高	△12,012	△14,121
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,109	4,503
当期変動額合計	△2,109	4,503
当期末残高	△14,121	△9,618
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△8,878	△11,290
当期変動額		
土地再評価差額金の取崩	206	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,618	912
当期変動額合計	△2,411	912
当期末残高	△11,290	△10,378
少数株主持分		
当期首残高	19,748	17,366
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,381	4,213
当期変動額合計	△2,381	4,213
当期末残高	17,366	21,579
純資産合計		
当期首残高	216,143	126,773
当期変動額		
新株の発行	―	45,000
当期純利益又は当期純損失（△）	△84,369	3,426
自己株式の取得	△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△5,000	5,125
当期変動額合計	△89,370	53,552
当期末残高	126,773	180,325

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成23年２月１日 至　平成24年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△55,637	3,903
減価償却費	51,998	32,333
のれん償却額	2,717	1,636
受取補償金	△10,003	△1,391
事業構造改善費用	58,115	2,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△594	△41
賞与引当金の増減額（△は減少）	△430	△329
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△423	△438
受取利息及び受取配当金	△89	△176
支払利息	3,751	3,237
固定資産除売却損益（△は益）	△59	52
売上債権の増減額（△は増加）	12,110	4,973
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,069	△34,383
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,927	3,005
仕入債務の増減額（△は減少）	3,177	784
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△10,203	149
その他	△11,617	3,737
小計	23,814	19,820
利息及び配当金の受取額	89	151
利息の支払額	△3,893	△3,301
法人税等の支払額	△1,093	△361
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,916	16,308
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△17,260	△16,276
有形固定資産の売却による収入	500	67
子会社株式の取得による支出	△810	△5
その他	97	985
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,472	△15,228
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,995	3,015
長期借入れによる収入	3,000	39,000
長期借入金の返済による支出	△27,724	△29,718
リース債務の返済による支出	△9,424	△9,560
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への配当金の支払額	△430	－
株式の発行による収入	－	44,766
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,583	47,502
現金及び現金同等物に係る換算差額	△272	367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△28,411	48,950
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△2,310
現金及び現金同等物の期首残高	53,876	25,464
現金及び現金同等物の期末残高	25,464	72,103

（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）会計方針の変更

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正（経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成23年法律第114号）及び法人税施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第379号））に伴い、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は198百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ208百万円増加しております。

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONの機械装置の減価償却方法は、従来、定率法によっておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。

当社グループは、平成24年2月の当社取締役会にて決議された「事業再生計画」に基づき、半導体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編に着手していることに加え、同社における増産投資が当連結会計年度中に順次稼働を開始することを契機として、同社が製造する製品の将来需要予測を踏まえ検討した結果、今後はより長期的かつ安定的な設備の活用が見込まれることから、当連結会計年度より同社の減価償却方法を定額法に見直し、将来にわたり変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,762百万円増加しております。

（７）会計上の見積りの変更

(有形固定資産の耐用年数の変更)

連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONの機械装置は、従来、耐用年数を8年として減価償却を行ってきましたが、当連結会計年度において「事業再生計画」の各種施策の遂行に伴う生産拠点の再編を契機として、耐用年数を12年に見直し、将来にわたり変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,439百万円増加しております。

(追加情報) 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

前連結会計年度（自平成 23 年２月１日　至平成 24 年１月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 24 年２月１日至平成 25 年１月 31 日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前連結会計年度（自平成 23 年２月１日　至平成 24 年１月 31 日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の 90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本	北米	アジア	欧州他	合計
87,895	38,682	102,645	17,954	247,177

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本	アジア	その他	合計
154,002	34,081	4,019	192,104

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Samsung Electronics Co., Ltd	39,932	高純度シリコン
住友商事株式会社	35,624	高純度シリコン

当連結会計年度（自平成 24 年 2 月 1 日　至平成 25 年 1 月 31 日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の 90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本	北米	アジア	欧州他	合計
68,395	31,152	92,497	14,645	206,691

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本	アジア	その他	合計
134,320	40,866	4,173	179,360

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Samsung Electronics Co., Ltd	29,656	高純度シリコン
住友商事株式会社	28,642	高純度シリコン

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自平成 23 年 2 月 1 日　至平成 24 年 1 月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 24 年 2 月 1 日至平成 25 年 1 月 31 日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自平成 23 年 2 月 1 日　至平成 24 年 1 月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 24 年 2 月 1 日至平成 25 年 1 月 31 日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自平成 23 年 2 月 1 日　至平成 24 年 1 月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 24 年 2 月 1 日至平成 25 年 1 月 31 日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自　平成23年2月 1日 至　平成24年1月31日)		当連結会計年度 (自　平成24年2月 1日 至　平成25年1月31日)	
1株当たり純資産額	424円47銭	1株当たり純資産額	436円94銭
1株当たり当期純損失金額(△)	△327円33銭	1株当たり当期純利益金額	8円93銭

(注) 1. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自　平成23年2月 1日 至　平成24年1月31日)	当連結会計年度 (自　平成24年2月 1日 至　平成25年1月31日)
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)		
当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円)	△84,369	3,426
普通株主に帰属しない金額(百万円)	―	1,125
(うち優先配当額(百万円))	(―)	(1,125)
普通株主に係る当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円)	△84,369	2,301
普通株式の期中平均株式数(株)	257,746,974	257,746,762
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(百万円)	―	1,125
(うち優先配当額(百万円))	(―)	(1,125)
普通株式増加数(株)	―	39,541,673
(うち優先株式数(株))	(―)	(39,541,673)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	A種種類株式 450株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

以　上